

证券代码：002414

证券简称：高德红外

武汉高德红外股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210817

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	广发基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、富国基金、中信建投证券、陕西成长基金、创金合信基金、中航基金、长信基金、华富基金、海通证券、广东恒健投资、望正资产、国新投资、星通投资、盘京投资、中再资产等机构及个人投资者（共计 106 人）	
时间	2021 年 8 月 17 日晚上	
地点	/	
上市公司接待人员姓名	董事长 黄立 副总经理、财务总监兼董事会秘书 陈丽玲	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长黄立介绍公司战略发展逻辑</p> <p>公司 2010 年上市以后，制定了公司的发展战略：</p> <p>一是选择一个好的行业。随着国家发展强大，国防领域将会是抗周期、高速发展的行业领域，同时因红外在民品领域的发展应用刚刚起步，所以在军、民两个方向均呈一个持续向上的态势。</p> <p>二是希望把高德建成为类似于“LS”这样既有核心竞争力、又有完整装备总体研发生产能力的、具有国际化、先进的高科技集团。围绕上述两方面，公司构建了公司三大核心竞争力：</p> <p>1) 在高科技国防领域掌握核心技术。红外热成像技术已</p>	

大量应用于我国国防以及诸多民用产品，从飞机、导弹、舰船、卫星、坦克以及单兵，各兵种基本都离不开红外热成像技术，是夜视夜战精确打击的核心平台。红外热成像技术可以在完全没有光线的情况下进行远距离探视，如观测上百公里外的飞机，坦克、装甲可以看到十几公里以外的目标。因此也成为敏感技术，造成西方国家对我国进行严格的技术封锁。

目前红外探测器主要有三种技术路线，第一种是投资界更熟悉的非制冷探测器第二种是更高端的碲镉汞制冷型探测器；第三种是采用更高端、更新技术的二类超晶格探测器，后两种制冷探测器主要应用于导弹、卫星等高端军用领域。目前公司在三个探测器的技术领域里都拥有完全自主知识产权的探测器技术、三条八英寸批量生产线，且公司技术水平也达到世界先进水平。在制冷型探测器的制造上，高德是唯一能够生产碲镉汞制冷型探测器的民营企业；而在最高端的二类超晶格探测器方面，在我国的民营企业、国有企业，军工集团或科研院所中，高德是唯一能够制造二类超晶格探测器的企业。今年公司百万像素中中波双色二类超晶格制冷红外探测器通过了科技成果评价，这项技术比单色二类超晶格要求的技术更高，相关参数已达到国际领先水平。

2) 完整装备系统总体。公司组建了 DD 研究院，在成功中标成为国内某完整装备系统总体后，经过多年的努力在去年成功取得了完整装备系统总体科研生产资质，成为了首家也是唯一的取得装备总体资质的民营企业。进入了装备总体领域，竞争层面、技术全面性和行业地位完全不一样了，这个资质含金量无比巨大。公司这些年在装备总体领域积累了丰富的技术和创新产品，目前正在进行的几个完整装备总体项目表现都很不错。

3) 构建了完整的高科技军工体系。公司通过十多年的时间构建了三十多个实验室，包括雷达、激光、数据链、人工智

能、发动机、战斗部、气动、飞控等，这样就构成了一个完整的军工体系。公司所有的研究室都是在一个涉密网下运行的，效率非常的高，这种体系的能力是公司未来与其他企业竞争中最核心的法宝。这种体系能力主要表现在三点，一是技术上的一体化设计，相互之间都能看到图纸，效率非常高，设计出来的精密度也很好；第二个是行政上的一体化指挥，没有那么多的配套单位相互之间掣肘导致效率变低，第三个是研发生产一体化。这也是公司十年前制定的战略，用先进的生产关系来锻造先进的生产力，通过 10 年的努力，高德已经构建完成完整的军工体系和能力。

通过这些年的努力，公司在手项目比较多，2018-2019 年开始进入公司的利润释放期，2020 年更是大幅上升，2021 年主营业务收入和利润增长非常快。公司在财务上也是保持比较稳健的风格，资产负债率一直维持在很低的水平，最高年份也就 30%左右。

二、2021 年半年度报告业绩解读

2021年半年度实现营收18.4个亿元，与去年同期相比增长幅度是57.04%，净利润接近7亿元，与去年同期相比增长34%。重点要强调一下公司红外焦平面探测器这一块的收入增长非常快，去年半年度芯片公司高芯科技营收为4.6亿元，今年是6.7亿元，营收的增长幅度是84%，利润的增长幅度从去年2.06亿元到今年4.6亿元，增幅为123%。与去年同期进行拆分比较，去年同期由于疫情的影响，半年度营收11.76亿元，其中防疫类产品交付近6亿元，而今年疫情防控进入常态化后，疫情防控类产品占营收的比重非常小，与去年半年度扣除掉疫情防控类产品后的营收相比，红外产品营收增长幅度达到了163%，在扣除疫情影响后，公司今年半年度红外主营业务增长幅度是非常快的。

三、互动问答

1、较去年同期，公司毛利率下滑原因？

去年公司红外热像仪及综合光电系统产品毛利率达到75.37%，汉丹机电的毛利率是27.17%，今年毛利率分别是64.26%、21.47%。汉丹机电毛利率下滑基于产品结构变化，根据每年不同时期交付的产品的业务结构不一样，会导致毛利率有一些变动，但是年底的数据基本保持在30%左右。今年红外产品毛利率虽不及去年，但与以往正常年度相比也是较高的；去年半年度存在特殊情况，某些产品芯片更新换代及供需关系等因素，体现的毛利率偏高。

去年红外探测器这块还有很多产能释放，目前的三条8英寸产线是十年前开始建设的，产线规模不及业务发展需求。新的产线（年底前投产）可以释放4-5倍的产能，会对明年带来更多贡献，一是性能提高，二是成本会下降，三是大规模批量化生产。

2、公司型号产品前期订单交付情况及对下半年订单的展望？

去年全年公告订单20多亿元，去年3季度、4季度的订单将在今年交付。上半年公告了12.32亿订单。在手订单充裕。今年半年度基本上全面保障型号产品订单的生产和交付。根据型号产品订货规律、项目进度，后续相应签署的合同订单达到披露要求将进行对外披露。订单披露有一定门槛，大额订单会披露，型号产品的小额订单、探测器以及民品的一些订单都没有公告。

3、完整装备系统总体方面，是否有订单确认了收入，去年签订的2个JM订单目前的履行情况，后续还会有订单吗？

去年对外公告的2个JM订单，预付款已经到账，产品已经生产完毕待交付，无特殊情况，年底前会交付；此类产品存在用户粘性，日常训练都会使用，不会轻易更换。交付的国家，具备经济实力、需求量较大，沟通过程中表达出会继续订货的

意愿，对未来业绩有好的影响。

4、市场上现在一致认为十四五前三年军品情况可期待，但再往后走会不会有极大萎缩的趋势？公司能否面对这个风险？

公司产品布局相对平衡。第一，公司产品涉及军民和民品两个领域；第二，公司核心器件包含了低端、中端和高端探测器三大类；第三公司拥有完整装备系统总体；第四公司的各个综合光电系统在各类兵种都有产品已经应用，所以在未来型号项目需求与供应方面将会持续均衡发展。

5、高德做到总体与军工集团进行竞争，会不会影响与他们的配套关系，公司如何来平衡这种又是总体、又做配套的市场定位？

在配套方面，公司一直保持着开放、积极配套、良好协作的合作态度，合作方都是看公司的产品和技术好不好，与是否是同属于同一集团没有关系。公司现在与军工集团下属的光电企业都有合作或者配套，我们秉承着诚信，某些情况我们甚至把对方的项目放在比我们自己项目优先的地位，在很多型号项目合作方面取得了非常好的成绩。一句话，把人做好、把事做好、把成本控制好，我们做好配套的同时还兼顾我们的伟大目标，把高德公司做成一个杰出的企业。

6、如何看待民品市场？公司在智能驾驶、机器视觉、智能家居、消费电子等各细分市场有哪些具体措施和策略？

公司对军品和民品都是一样重视的，下设几个子公司专攻民品领域。近年来红外在民品市场是快速增长的，但民品市场的基数目前还不是很大，我们认为民品未来市场具备快速增长达到几十亿规模的潜力。在应用场景上，汽车自动驾驶未来市场空间巨大；智能家居方面公司与空调厂商开展合作，预计很快可以推出；公司产品在安防监控、消防等方面也有很大的需求。民品市场上，成本问题还是很关键的。公司持续致力于民

品低成本、小型化，我们是国内第一家完成晶圆级封装的企业，目前还在做像素级封装，成本将进一步降低，预计对公司产品的市场竞争力、市场占有率提升，以及对民品市场的全面发展会起到很大的作用。

7、募投项目增加的产能如何消化？

公司再融资探测器芯片扩产项目进展顺利。目前公司拥有的3条探测器生产线是10年前投入的，在生产更先进的产品时会存在一些制约。在新产线建好后，随着产线设备性能提升，未来公司产品质量更好；新产线建好后，随着产能增加，应对市场快速需求时有能力快速供应。另外民用市场增长比较快，公司民品市场的合作单位也很多，未来需求旺盛，所以产能储备很有必要。

8、从战略角度，黄董未来计划把公司带往哪个方向？公司对于未来人才梯队建设是如何考虑的？公司对未来股权和资本合作层面是怎么打算的？

公司的战略简化来讲就是希望把高德公司做成中国的LS，成为一家既掌握核心芯片、又有完整装备系统总体的具有完整军工体系、小而高效的民营高科技集团。没有核心芯片公司则不强，没有总体公司则不大。同时公司坚持走军、民并进的道路上，用军品牵引技术高度，用民品的大批量优化成本和竞争力，军、民品共同形成未来的巨大规模。在未来的发展过程中，公司将在任何时候都围绕着紧跟党中央为国家服务，为国家更加强大而努力，公司的发展将是稳健且可预期的。

在人才梯队建设方面，公司高管团队非常稳定，公司高管多数已在公司服务了十年以上，年富力强且能独当一面。公司经营运作已成体系化，制度健全，职责权限清晰。我认为，公司完整的军工体系和三个“一体化”是高德最具有竞争力的方面，公司无论在管理团队还是科研技术方面均已非常成熟且成体系。

	<p>在未来的股权和资本运作方面，第一是立足本身健康快速发展，第二是以开放的心态面对可能的资本合作，公司会秉承谨慎全面的研判，以高德公司能否发展的更好为标准进行审慎决策。</p> <p>注：本次机构调研未发生未公开重大信息泄密情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年8月17日